

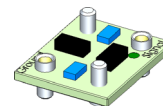


DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

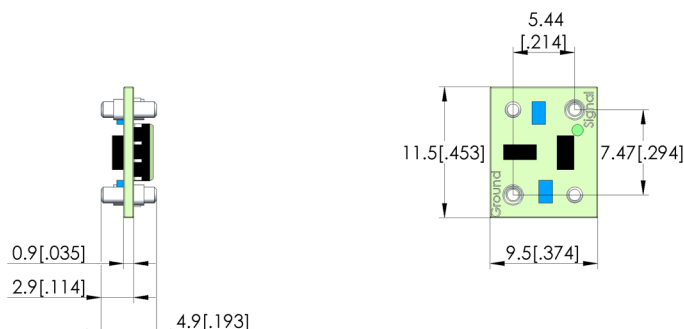
- Componenti per il test Opens per il test capacitivo di chip semiconduttori alla ricerca di guasti, cortocircuiti e difetti di saldatura
- Adatto ai sistemi di test Teradyne

Utilizzo

Le piastre elettroniche FrameScan FX 2.0 sono utilizzate per i test capacitivi dei circuiti integrati al fine di verificare le connessioni a filo all'interno di un circuito integrato per individuare circuiti aperti, cortocircuiti e difetti di saldatura.



1:1



Dati generali

Gruppo di prodotti:	opens test
serie:	OTC
Tipo:	Teradyne opens test
Versione:	FrameScan FX 2.0
Tipo di accessorio:	accessori di ampliamento
Stato di consegna:	Piastra elettronica
Larghezza:	9,5 mm
Altezza:	4,9 mm
Peso:	0,01 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA):
Kit di ricambio WS:

VA 20xx
WS Teradyne/TSH5x

Dati tecnici

Lunghezza:
Dimensioni esterne (LxPxA):

11,5 mm
9,5 x 11,5 x 4,9 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

